

千住金属工業

# フラックス製品拡充

## 目的・用途に応じて提案

千住金属工業は、はんだビジネスで合金製品に加えて、半導体実装に欠かせない各種フラックス製品を目的や用途に応じて幅広く取りそろえている。

炉を汚さず水で洗浄できる低揮発フラックス、洗浄工程を省略する無残渣フラックス、低価格Cu-OSP基板でも良好な濡れ性を約束する各種フラックス、フリップチップ実装でのソ

ルダボール凹みを解決するフラックスなどがある。

「セミンコン台湾2012」にも出展して、これらの製品を紹介した。

スマートフォンに代表さ

れるモバイル機器用として、耐落下衝撃性に優れたソルダボール「M61」、はんだ量が不足するパッドやスルーホール部に接合補強するチップソルダ、車載用やパワーモジュールな

どに耐熱疲労特性に優れたソルダペースト「M53」やソルダボール「M60」、テレビに採用された実績がある「低銀M40」「M46」、180度という低温実装可能な「Sn-Bi系ソルダペーストL23」などの合金を紹介。同展示会では、3D実装用として基板内蔵の空間確保を容易とする「Cu核ソルダボール」や、狭ピッチ実装を実現する「転写用はんだPPS」、低温焼結が可能で高温でも溶融しない「銀ナノペースト」などもそろえた。



半導体実装向け製品を幅広く取りそろえている